

# 硅系导热凝胶 TS200

## Silicone Thermal Conductive Gel TS200

### 产品概述

TS200 是单组分导热凝胶，该产品具有优秀的导热性能，施胶后具有极低的应力从而方便各种组装应用，同时，该产品具有出色的长期可靠性。该产品具有触变性，方便点胶。该产品已经经过预固化，可以直接常温使用，而不再需要固化、混合或者冷冻存储。

本产品的触变性和自然黏附性保证了它会在发热器件周围定形并且在最终产品的使用过程中始终保持在原来的位置上。本产品适用于自动化施胶工艺，可以极大地提高生产效率。可典型应用于电动汽车电池组、汽车电子设备、LED 照明、主机和小型办公室网络设备、大型存储设备及智能手机模块和消费电子等产品中。

### 产品特性

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 外观                                 | 浅黄色粘稠液体 |
| 粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))    | 150000  |
| 密度 (ASTM D792, g/cm <sup>3</sup> ) | 2.9     |
| 挤出速率 (2mm 针头 90psi, g/min)         | ≥10     |
| 储存条件 (<25°C, 6 months)             | 12      |

### 产品性能

| 项目   | 测试方法       | 单位           | 数值               |
|------|------------|--------------|------------------|
| 导热系数 | ASTM D5470 | W/mK         | 2.0              |
| 体积电阻 | ASTM D257  | Ohm-meter    | 10 <sup>13</sup> |
| 总失重  | ASTM E595  | %            | 0.01             |
| 阻燃等级 | UL94       | --           | V-0              |
| 介电常数 | ASTM D150  | 25 oC, 1 kHz | 8.1              |
| 介电强度 | ASTM D149  | kV/mm        | 10               |
| 操作温度 | --         | oC           | -60-200          |

### 产品包装及货期

|             |               |
|-------------|---------------|
| 小包装         | 30CC、300CC 针管 |
| 大包装         | 20L 桶装        |
| 最小包装量 (MPQ) | 30CC          |
| 最小订单量 (MOQ) | 30CC          |
| 交货期 (L/T)   | 10-15 个工作日    |